

应用介绍

特点

一款单组份环氧树脂导电胶，可低温固化；使用于多种材料之间的粘接，耐高温低CTE等特点，尤其适用于电子元器件导通及热敏感器件粘接

粘接材料

金属，陶瓷，塑料/PCB，玻璃等

典型应用

电子元器件导电粘接

固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	环氧树脂	
颜色	银色	
粘度(cps)	6000	10rpm@25°C, ASTM D-1084
固化条件*	2hrs@70°C	
有效期@ -5°C,月	6	

*固化温度是指达到胶水表面的实际温度

固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	银色	
邵氏硬度	75D	ASTM D-2240
玻璃化温度 Tg	98°C	DSC, TA Q20, 40°C/MIN
导电率	5×10^{-4} ohm*cm	IEC 60167:1964,IDT
降解温度	360°C	

可靠性	数值	测试方法
固化失重	<1%	
工作温度范围*	-55°C—150°C	

储存和使用方法

产品需低于-5°C环境中保存，使用前请先移至室温解冻，30ml 包装至少回温 2 小时。使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他使用注意事项请参考 SDS 文件；

注：

本技术参数表所包含的参数是本产品最真实可靠的参数。对于其它机构测得的数据我们无法承担责任。客户最终决定本产品是否适用其工艺，对于生产过程中因使用不当产生的问题无法承担责任。我们建议客户正式使用前请做好各种测试工作。

研发期间产品参数不作为最终参数，仅供参考。

